

# PRESS RELEASE

報道関係者各位

2016年5月25日発信

## 電子機器トータルソリューション展 JPCA 賞(アワード)・JPCA 奨励賞 受賞企業決定

(出展者(NPI)プレゼンテーションでは各企業の最新技術論文が発表されます)

この度、JPCA 賞 (アワード) 選考委員会にて、厳正なる審査の上、第 12 回 JPCA 賞 (アワード) 受賞企業及び、JPCA 奨励賞が下記の通り決定致しましたので、お知らせ致します。

JPCA 賞 (アワード) は、JPCA Show 2016 他 4 展示会出展者による新製品・新技術紹介「出展者 (NPI) プレゼンテーション」参加企業の中から、応募のあった発表内容の『独創性 (独自性・オリジナリティ)』、『産業界での発展性・将来性』、『信頼性』、『時世の適合性』を審査基準として、学术界、電子回路業界、専門誌編集者等有識者の方々に構成する JPCA 賞 (アワード) 選考委員会によって厳正な審議を行い、電子回路技術及び産業の進歩発展に顕著な製品・技術への表彰制度として 2005 年より実施しています。

第 12 回の受賞企業は 14 社 19 件の中から 8 件の製品・技術が選ばれました。

(講演プログラムは右の QR コードより)



### JPCA 賞(アワード)受賞者

- 設備状態監視のキーデバイスを担うプリント基板プロセスで実現した高感度エネルギーセンサ  
株式会社デンソー 【小間番号：5E-04】
- 極薄 FPC ビルドアップ用フレキシブル樹脂付き銅箔 FeliosFRCC 『R-FR10』  
パナソニック株式会社 【小間番号：2D-24】
- $L/S=2/2\mu m$  の超微細回路形成および最終表面処理プロセス UFP プロセス  
奥野製薬工業株式会社 【小間番号：2C-24】
- 低伝送損失基板を実現する低誘電・高接着ポリイミド樹脂「PIAD」  
荒川化学工業株式会社 【小間番号：4C-28】
- 次世代高周波対応新規伝送損失・低熱膨張多層材料 MCL-HS100  
日立化成株式会社 【小間番号：2D-12】
- 最新の蛍光 X 線膜厚計によるめっき厚測定と微細パターンを持つ電子回路基板への適用  
株式会社日立ハイテクサイエンス 【小間番号：5E-08】

### JPCA 奨励賞

- 環境対応・高機能型 ほう素フリースルファミン酸ニッケルめっき薬品  
日本化学産業株式会社 【小間番号：2B-07】
- 熱設計のパラダイムシフトに対応するために  
KOA 株式会社 【小間番号：5B-16】

なお、第 12 回 JPCA 賞 (アワード) の授賞式は 6 月 1 日 16:30 より東 5 ホール【5H-27】にて実施されます。

以上